

**新製品「300mm ウェハ対応マルチチップ同時測定 DC/UIS ワンパステストシステム」  
に関するお知らせ**

**【概要】**

この度当社は、パワー半導体 300mm ウェハにおいて、高速且つ、高品質な静特性(DC)及びアバランシェ耐量(UIS)試験をワンタッチダウンでマルチチップ同時測定可能な DC/UIS ワンパステストシステム(471-TTL)を製品化したしました。

**【内容】**

EVをはじめとするモビリティの電動化が進む中、モーター等の誘導性負荷を制御する役割を担うパワー半導体のウェハ測定において、静特性(DC)だけでなく、品質の高いアバランシェ耐量(UIS)測定が求められています。またパワー半導体コスト削減のためにウェハ口径の300mm 化も進んでいます。

このようなニーズを受け、当社ではプローバとのダイレクトドッキングを実現し、DC 及び UIS 試験をワンタッチダウンで測定可能にしたテストシステムを開発いたしました。また同システムは1枚当たりのチップ数が多い300mm ウェハのマルチチップ同時測定を実現し、スループットも大きく向上させました。

**【特徴】**

- ・東京精密社製プローバ(AP3000 DARUMA チェック仕様)とのダイレクトドッキング方式の採用により、寄生成分(容量、インダクタンス等)を最小化し、ウェハ上でDC測定に加えて高品質なUIS測定を実現。
- ・ウェハ上での4チップ同時測定を可能とし、高スループットを実現。(注)一部の測定においてはシリーズ測定。
- ・デバイス破壊時のシステム保護を目的とした印加電流の高速遮断を実現。

**【お問い合わせ先】**

〒207-0023 東京都東大和市上北台3丁目391-1

株式会社テセック 営業統括部

TEL: 042-566-2111, E-mail: [info@tesec.co.jp](mailto:info@tesec.co.jp)

当社は今後もパワー半導体における検査装置のリーディングカンパニーとして、お客様のニーズに応え、高品質な測定を実現する製品を通して、社会に貢献して参ります。

以上